SP-355
高导热电子零件灌注胶

UL File No. E354546

特　　点

- 通过 UL94 V-0 耐燃等级，低黏度容易混合操作与灌注。
- 低收缩，适合应用在对温度与应力敏感的组件或模块。
- 可常温硬化或加温加速硬化，导热性及电气特性佳。

物　　性

		主剂 (A剂)		硬化剂 (B剂)
颜　　色		白 色		黑 色
黏　　度		2,600 – 3,600 cps		3,100 – 4,100 cps
比　　重		1.72 – 1.74		1.72 – 1.74
重量混合比		100	:	100
混合后颜色		灰黑色		
混合后黏度	@25°C	3,000 – 3,800 cps		
混合后比重	@25°C	1.72 – 1.74		
可操作时间	@25°C	1 – 2小时		
硬化条件		25°C x 18 – 24 小时 或 80°C x 0.5 – 1 小时		
硬　　度	Shore A	45 – 55		
工作温度		-50°C ~ +200°C		
热传导系数		0.8 W/mk (0.46 BTU/hrs/FT^2/FT/°F)		
热膨胀系数	@0~100°C	2.06 x 10^{-4} in/in/°C		
绝缘强度		18 kV/mm (457 volts/mil)		
抗张强度		1.2 Mpa (174 psi)		
断裂伸长率		80 %		
体积电阻		2.2 x 10^{15} ohm-cm		
绝缘常数	1MHz	3.0		
消散因素	1MHz	2 x 10^{-3}		
保存期限	@25°C	6 个月 (未开封)		

注 意 事 项

1. 部分含有硫、磷、氮元素等有机化合物，可能会抑制或干扰硫化反应，而造成不易硬化。对于有使用脱模剂、含硫材料、或基板上有助焊剂残留物、有机金属化合物等，请先少量试用确定是否有影响，或是灌胶前加强清洁工作。
2. 如果灌注成品内部包裹气泡，建议降低灌胶深度，分次灌胶。或是在灌胶前后对树脂或灌注模块进行真空脱泡，以获得最佳外观。
3. 开封后请尽速用完或是密封，避免受潮。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672　台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707　苏州：86-512-66106145

杰研贸易（上海）有限公司
www.jasdi.com.cn • jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975 • FAX：021-58356976